

产品介绍

PGN-200LV 是一款低密度双组份导热硅凝胶，固化前粘度低，触变性良好，易点胶。室温条件下两种组份混合后，产品会快速固化，固化后性能稳定，具有卓越的抗冷热变化、抗紫外线、耐老化、绝缘、抗震和耐化学介质等性能。配合点胶机作业，适用于需要填缝，低机械应力等电子组件之间。

产品特点

- 易浸润，易点胶，可自动化操作
- 低应力，可压缩
- 优异的导热速率
- 耐高压，高绝缘，抗震，抗冷热变化
- 阻燃达 UL94 V-0

主要用途

- 手机，电脑，通讯模块，TV
- WIFI 模块，路由器，传感器
- 大功率电器，LED 灯
- 快充头，光伏逆变器，智能家电
- 动力电池模组，连接器，变压器，需绝缘和散热部件等

环保要求

- 该系列产品符合 RoHS，卤素管控标准

使用说明

- 被粘器件表面必须清洁干燥，无灰尘、油污及水渍。
- 使用时，把混合后不均匀部分舍弃，然后再正常使用。
- 建议施工环境温度 5 ~ 35°C。环境温度较高时操作适用期有所缩短。
- 施工方法可参照施工说明或咨询我司技术人员。

安全注意事项

- 本品属非危险品，但勿入口眼。
- 胶料应密封贮存。胶料混合好后应一次性用完，避免造成浪费。

技术参数

	测试项目	技术指标
固化前	颜色	A:白色 B:黄色
	粘度(cps,25°C) 参考 GB/T 2794	A:120000±10000 B: 120000±10000
操作性能	体积比 (A:B)	1:1
	混合后密度 g/cm ³ 参考 ASTM D792	2.5±0.5
	适用期 min 参考 JC/T 2560	≥30
	完全固化时间 h 使用环境实测	24
固化后	硬度 shore 00 参考 ASTM D2240	50±10
	导热系数 W/(m·K) 参考 ASTM D5470	2.5±0.2
	体积电阻率Ω·cm 参考 ASTM D257	≥1.0*10 ¹²
	介电强度 KV/mm 参考 ASTM D149	≥6.5
	阻燃等级 UL 94	V0
	适用温度 °C 参考 EM344	-40 ~ 200
	环保性能 RoHS	Pass

以上是在23±2°C、50±5%RH下的检测数据；环境温度湿度的不同，测试值会有所差异。

包装规格

- 25+25cc 塑料双管
- 200+200cc 塑料双管
- 可依客户要求定制

运输贮存

- 防潮，防晒，远离热源，小心轻放，禁止挤压碰撞。
- 避免本品催化剂中毒而失去活性，应避免物料接触含氮、磷、硫的化合物及有机锡之类的重金属化合物，保持器皿洁净。
- 保质期：6个月

该资料中所包含的真实可靠的数据信息旨在协助您采用广迈导热硅凝胶材料进行的设计，基于我们目前的认知和经验确定的产品应用范围，无意且不构成任何明示的或隐含的担保，包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本资料中显示的结果。对于范围之外的应用，或者是不同条件和环境下的使用，产生的结果广迈将不负任何责任。因此我们强烈建议用户在使用之前应确定广迈导热硅凝胶材料的适用性。

Add : 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心 16 座 B 栋

Tel: 0769-26621791

Web: <http://www.guangmai.com>

发布日期：2022-06-25